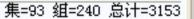


文件(图) 编辑(图) 工具(图) 帮助(图)



D:\wangfan footprint sch





▲ 球栅阵列封装 (BGA) 贴片铝电解电容



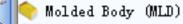
片状元件



🧖 片状网络元件(电阻排、电容排) 平面栅格阵列(LGA)



■ 圆柱形表面组装器件(MELF)



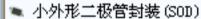
■ 晶振 (OSC)



● 四侧无引脚扁平封装 (QFN)



■ 小外形封装IC (SOIC)



◆ 小外形J型引脚封装(SOJ)



▶ 小外形封装晶体管 (SOT)

♠ 晶体管外壳 (TO)

□□ 按键类

重 通用连接器

🔨 安装、定位孔

☞ 通孔类元件



🧿 镀锡焊盘

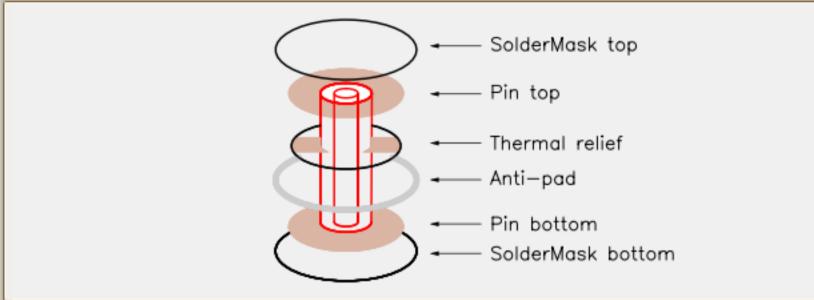
💍 非镀锡焊盘

🧿 过孔

光学定位点

🔵 测试盘

黑 自定义封装









Allegro

PAD + 煙盘尺寸 + D + 孔 直径 + S/方形)

PAD+)字盆尺寸+D+孔且位+S(万形)										
脚	完成的 孔径	顶层 焊盘	内层 焊盘	底层 焊盘	Plane Anti-Pad	花焊盘 内径	花焊盘 外径	花焊盘 缺口	描述	
0.20	0.50	0.85	0.85	0.85	1.25	1.00	1.25	0.35		
0.25	0.55	0.95	0.95	0.95	1.35	1.05	1.35	0.35		
0.10	0.40	0.70	0.70	0.70	1.15	0.90	1.15	0.35		
0.15	0.45	0.75	0.75	0.75	1.20	0.95	1.20	0.35		
0.75	1.05	1.75	1.75	1.75	1.90	1.55	1.90	0.40		
0.80	1.10	1.85	1.85	1.85	1.95	1.60	1.95	0.40		
0.65	0.95	1.60	1.60	1.60	1.75	1.45	1.75	0.40		
0.70	1.00	1.65	1.65	1.65	1.80	1.50	1.80	0.40		
0.95	1.25	2.05	2.05	2.05	2.10	1.75	2.10	0.40		
1.00	1.30	2.15	2.15	2.15	2.15	1.80	2.15	0.40		
0.85	1.15	1.90	1.90	1.90	2.00	1.65	2.00	0.40		
0.90	1.20	2.00	2.00	2.00	2.05	1.70	2.05	0.40		
0.40	0.70	1.15	1.15	1.15	1.50	1.20	1.50	0.40		
0.60	0.90	1.25	1.25	1.25	1.60	1.30	1.60	0.40		
0.30	0.60	1.00	1.00	1.00	1.40	1.10	1.40	0.40		
0.35	0.65	1.10	1.10	1.10	1.45	1.15	1.45	0.40		
0.55	0.85	1.40	1.40	1.40	1.65	1.35	1.65	0.40		
0.60	0.90	1.50	1.50	1.50	1.70	1.40	1.70	0.40		
0.45	0.75	1.25	1.25	1.25	1.55	1.25	1.55	0.40		